

静电防护二极管 : TExSD92 系列

SOD-923 封装



■ 特性

1. 符合RoHS与无卤要求
2. 低限制电压
3. 低漏流
4. 满足 61000-4-2 (ESD) 15~25KV (air), 8~25KV (contact)



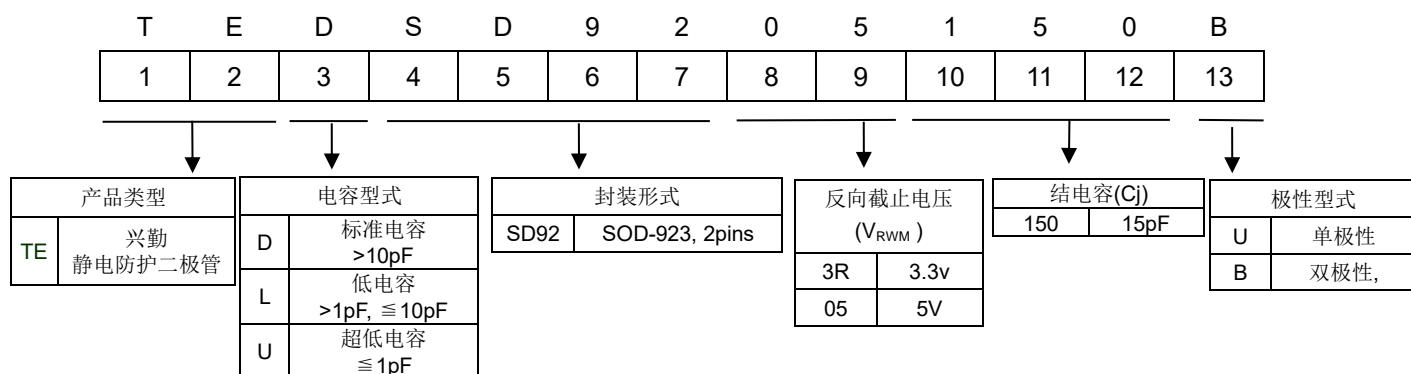
■ 用途

1. 笔记本电脑, 服务器
2. USB接口
3. 个人数字助理 (PDA)
4. 网络和电信 (Ethernet 10/100/1000 Base T)

■ 机械数据

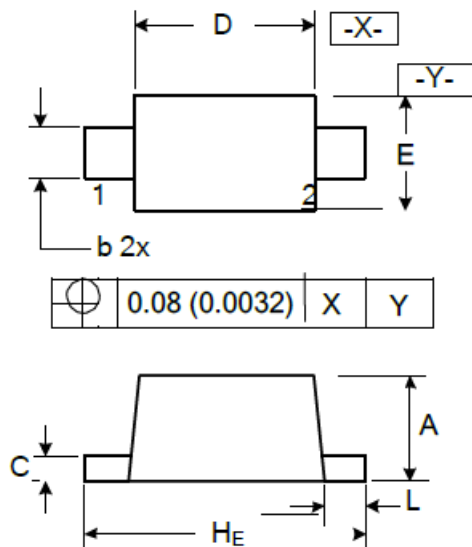
1. 封装型式: SOD-923, 封装塑料符合防火等级UL94-V0
2. 满足MSL level 1, per J-STD-020

■ 编码规则



SOD-923 封装

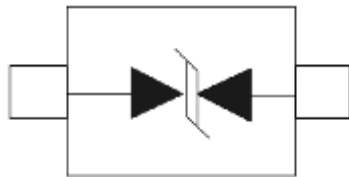
■ 结构与尺寸



单位: mm

Symbol	SOD-923	
	Min.	Max.
A	0.36	0.43
b	0.15	0.25
C	0.07	0.17
D	0.75	0.85
E	0.55	0.65
H _E	0.95	1.05
L	0.05	0.15

■ 图标概要与配置



■ 电气特性 (T_A=25°C)

兴勤料号	最大反向截止电压	反向漏电流	产品极性 单/双向	印字	峰值脉冲功率	峰值脉冲电流	接触放电	空气放电	工作温度	存储温度
	V _{RWM} (V)	I _R (uA)	Uni/Bi (单/双)		P _{PK} (W)	I _{PP} (A)	KV	KV	T _J (°C)	T _{stg} (°C)
	Max	Max								
TEDSD923R150B	3.3	0.1	Bi	IC<:H	100	8	25	25	-55 to +150	-55 to +150
TEDSD9205150B	5	1	Bi		100	6.5	±8	±15	-55 to +125	-55 to +150



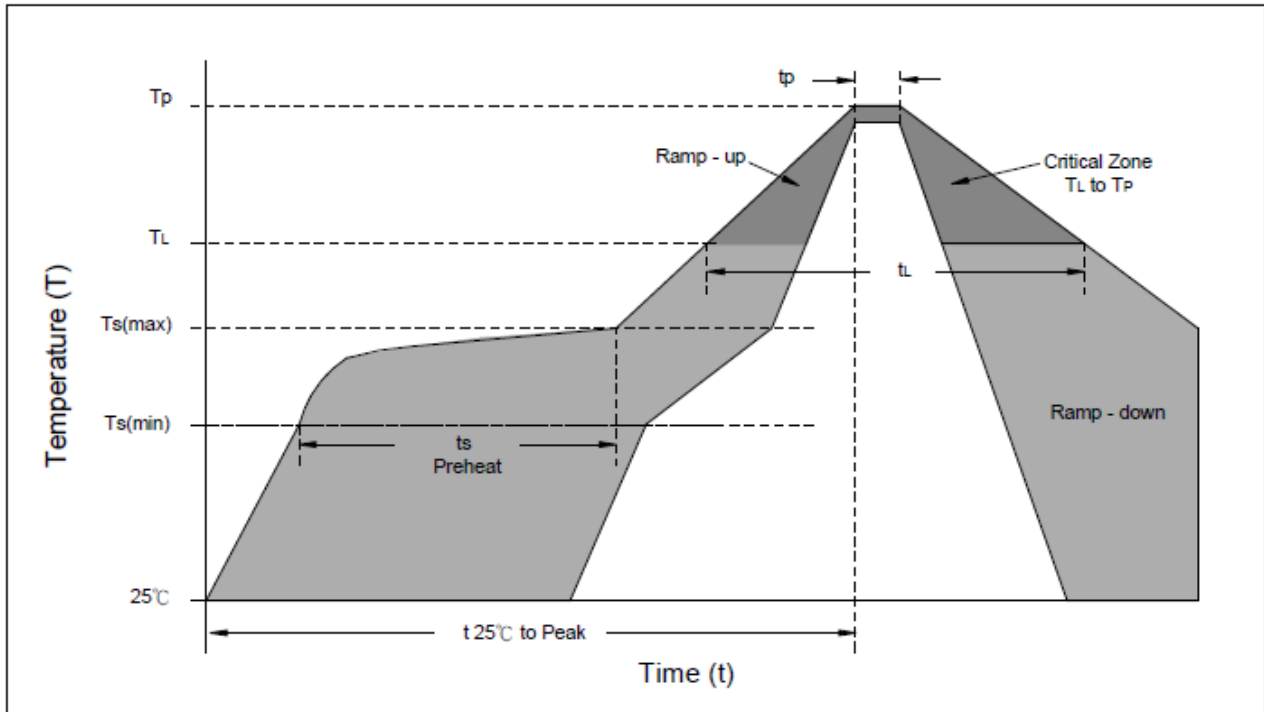
■ 电气特性 (T_A=25°C)

TEDSD923R150B						
Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Reverse Working Voltage	V _{RWM}			3.3	V	
Breakdown Voltage	V _{BR}	5.0		7.0	V	I _T = 1mA
Reverse Leakage Current	I _R			0.1	uA	V _R = V _{RWM}
Clamping Voltage	V _C			11.5	V	I _{PP} = 2A (8/20μs pulse)
Junction Capacitance	C _J		15		pF	V _R = 0V, f = 1MHz

TEDSD9205150B						
Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Reverse Working Voltage	V _{RWM}			5	V	
Breakdown Voltage	V _{BR}	6.0			V	I _T = 1mA
Reverse Leakage Current	I _R			1	uA	V _R = V _{RWM}
Clamping Voltage	V _C			9.5	V	I _{PP} = 1A (8/20μs pulse)
			13.5	15	V	I _{PP} = 6.5A (8/20μs pulse)
Junction Capacitance	C _J		15		pF	V _R = 0V, f = 1MHz

SOD-923 封装

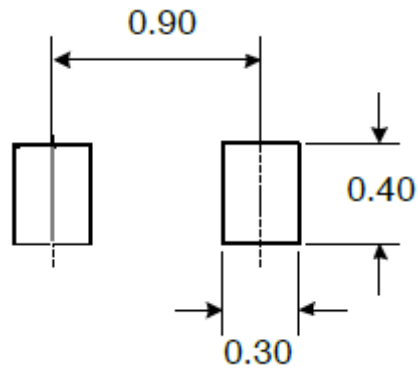
■ 推荐焊接条件



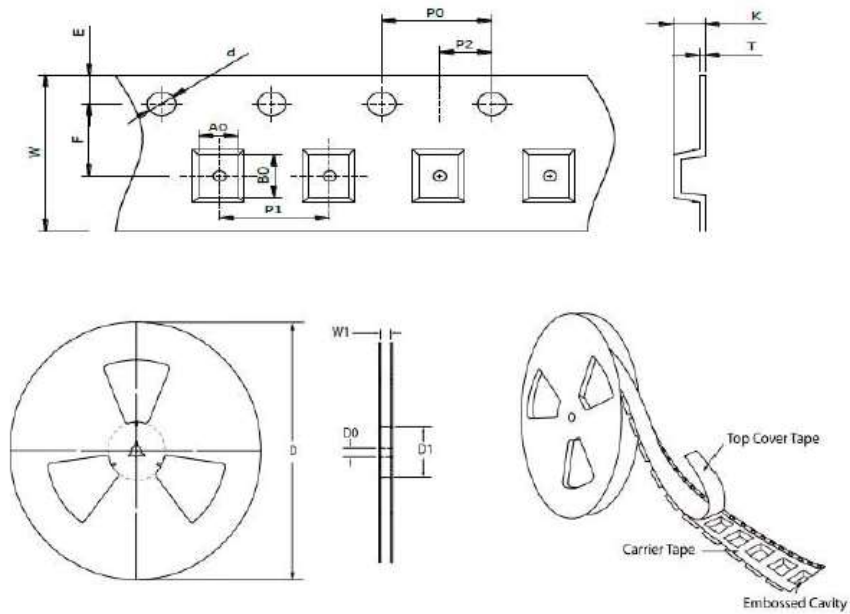
Reflow Condition	Lead-free assembly
Preheat	
-Temperature Min(Ts min)	150°C
-Temperature Min(Ts max)	200°C
-Time (min to max) (ts)	60 – 180 seconds
Average ramp up rate	
-Temperature Liquidus (TL) to peak	3°C/second max
Ts(max) to TL	
-Ramp-up Rate	3°C/second max.
Reflow	
-Temperature Liquidus (TL)	217°C
-Time (tL)	60 – 150 seconds
Peak Temperature (TP)	260°C
Time within 5°C of actual peak Temperature(tp)	20 – 40 seconds
Ramp-down Rate	6°C/second max.
Time 25°C to peak Temperature(TP)	8 minutes max.
Do not exceed	260°C

■ 推荐焊盘尺寸

单位:mm



■ 包装





■ 数量

最小包装数量(MPQ): 8,000pcs

封装型式	卷盘尺寸(英寸)	单卷数量(Kpcs)
SOD-923	7	8

■ 仓库存储条件

● 存储条件:

1. 储存温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
2. 相对湿度: $\leq 75\% \text{RH}$
3. 不要将本产品存放在有腐蚀性气体或是阳光直接照射的环境中保管

● 存储期限: 1 年